

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2023-04-001

投资者关系 活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会（2022 年度） <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与人员	线上参与公司 2022 年度业绩说明会的全体投资者
时间	2023 年 04 月 07 日 15:00-17:00
网址	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）
上市公司接 待人员姓名	董事长、总经理：邱醒亚先生 独立董事：王明强先生 副总经理、财务负责人：王凯先生 副总经理、董事会秘书：蒋威先生 保荐代表人：曾文强先生
投资者关系 活动主要内 容介绍	<p style="text-align: center;">本次业绩说明会采取文字问答方式与投资者进行交流，2022 年度业绩说明会主要内容整理如下：</p> <p style="text-align: center;">1、ABF广州工厂的进度。</p> <p>回复：尊敬的投资者，您好。广州FCBGA封装基板项目从2022年4月22日动工，历时5个月完成厂房封顶，预计2023年第四季度完成产线建设，开始试产。感谢您的关注！</p> <p style="text-align: center;">2、关于揖斐电，收购的主要目的是他的技术、客户or渠道？何时完成收购？对今年的业绩会产生正面有利影响吗？</p> <p>回复：尊敬的投资者，您好。北京揖斐电自2000年成立以来，以HDI、</p>

Anylayer HDI、类载板、模组基板为主要产品，具备独立的研发体系和客户群体，与部分主流手机品牌和芯片企业建立起稳定的合作关系。收购完成后，有望与公司在产品、技术、客户层面产生协同效应，实现从高多层PCB、Anylayer HDI、类载板、CSP封装基板和FCBGA封装基板产品的全领域布局。目前正处于审计阶段，后续进展请留意公司公告。感谢您的关注！

3、关于IC载板(包括FCBGA和CSP)，已投、在建、拟建分别是多少，需多久可全部建成、投产？对未来的规模和利润是否有规划？

回复：尊敬的投资者，您好！珠海FCBGA封装基板项目拟建设产能200万颗/月（约6,000平方米/月）的产线，已于2022年12月底建成并成功试产，预计2023年第二季度开始启动客户认证，第三季度进入小批量产品交付阶段。广州FCBGA封装基板项目拟分期建设2000万颗/月（2万平方米/月）的产线，一期厂房已于2022年9月完成厂房封顶，预计2023年第四季度完成产线建设、开始试产。现有CSP封装基板产能为3.5万平方米/月，其中广州基地2万平方米/月，珠海兴科项目1.5万平方米/月。未来的收入和利润取决于市场需求、公司量产进度和客户开拓情况。感谢您的关注！

4、贵司年报指出PCB行业景气下行，竞争激烈，但机构认为在6G、AI、AIGC、CHIPLET、储存器加持及国产替代的背景下，行业有很大增长空间，部分PCB大厂业绩也逆势增长，相比之下，贵司增长乏力，是否说明在PCB中、小样板方面遇到了瓶颈？如何保持在中、小样板方面的领军地位，贵司是如何计划和打算的？行业何时触底回升？

回复：尊敬的投资者，您好！2022年公司收入增长6.23%，领先于行业同比1%（Prismark数据）的增速，净利润有所下滑主要受费用拖累，其中FCBGA封装基板项目费用投入10,200万元，珠海兴科CSP封装基板项目亏损8,292.6万，员工持股计划费用摊销约4,951万，对当期利润形成较大拖累。在传统PCB领域，公司暂未做过多的产能扩张，主要通过数字化改造提升良率、交付能力来提升整体竞争力。从行业需求判断，2023年PCB行业应该是前低后高趋势，2023年Q1同比增速难有改善，预期Q2开始环比改善，三四季度行业同比增速有望转正，整体回暖幅度取决于宏观经济复苏的力度。感谢您的关注！

5、2022年研发投入及占比；已有专利和新增专利的情况？2023年研发投入力度会继续加大吗？FCBGA核心技术团队是否已成立，开始运作？

回复：尊敬的投资者，您好。2022年研发投入为3.83亿元，占营业收入比例的7.15%，2022年度，公司及下属子公司累计申请中国专利42项，其

中申请发明专利27项，申请实用新型专利15项；已授权中国专利35项，其中发明专利18项，实用新型专利17项。截至2022年12月31日，公司及下属子公司累计申请中国专利1,017项，其中发明专利560项，实用新型专利456项，外观设计专利1项；申请PCT国际专利68件。累计拥有授权且仍有效中国专利575项，其中发明专利297项，实用新型专利277项，外观设计专利1项；累计拥有授权且仍有效国外发明专利12项。2023年公司将继续加大研发投入。珠海FCBGA封装基板产线已于2022年12月底建成并成功试产。感谢您的关注！

6、光模块产品是否有新品推出？

回复：尊敬的投资者，您好。光模块是公司产品重要的下游应用领域，公司与部分头部客户在传统光模块领域建立起稳定的合作关系，量产的光通信产品的类型覆盖10G~400G。在新技术开发方面配合客户，通过mSAP工艺关键技术及应用研究，攻克高精度线路技术控制难点，为多层有机载板及800G光模块产品制作奠定基础，目前尚未推出新产品，800G产品在样品阶段。感谢您的关注！

7、路维光电是公司的参股企业之一，其上市对公司账面的财务收益是否有所反映？

回复：尊敬的投资者，您好。路维光电是公司参股企业之一，在其他权益工具投资核算，其公允价值变动在其他综合收益中反映。感谢您的关注！

8、对 FCBGA 和其它 IC 载板，除三星、华为外，有打算拓展苹果、英伟达、小米、长江、长鑫等国内外大客户的计划和规划吗？

回复：尊敬的投资者，您好！公司在 CSP 封装基板领域已与国内外主流客户建立起稳定的合作关系，FCBGA 封装基板项目尚在建设过程中，会努力拓展国内外龙头企业客户。感谢您的关注！

9、公司产品 pcb 中，铜的占比多少？

回复：尊敬的投资者，您好！覆铜板主要由铜箔、玻纤布等制成，其中铜箔占覆铜板成本最大，通常薄板中铜箔成本占比为 30%左右，厚板中铜箔成本占比为 50%左右。不同的产品要求不同。感谢您的关注！

10、公司产品下游应用以手机等消费电子占比高吗？去年库存量大吗？今年去库存压力如何？

回复：尊敬的投资者，您好！公司并不直接涉足消费电子行业，受影

响相对较小。下游应用以通信、服务器、安防、工控、医疗、半导体等行业为主。库存处于正常水平。感谢您的关注！

11、珠海 FCBGA 封装基板项目产能有多少？

回复：尊敬的投资者，您好！珠海 FCBGA 封装基板项目产能为 200 万颗/月（约 6,000 平方米/月）。感谢您的关注！

12、公司在 chatgpt 中的应用处于怎么样的地位？

回复：尊敬的投资者，您好！公司并未直接参与 Chatgpt 及相关应用的开发，公司专注于印制电路板产业，配套提供芯片国产化和封装测试环节的关键材料，CSP 封装基板和 FCBGA 封装基板为芯片封装环节的关键材料，ATE 测试板应用于晶圆测试和封装后测试的各环节。感谢您的关注！

13、公司一边在扩产，一边消费需求萎靡，请问公司不会担心产能过剩吗？

回复：尊敬的投资者，您好！现阶段受国际政治环境、宏观形势影响，行业景气度下行、竞争加剧，公司也阶段性面临需求不足的压力。公司扩产的方向聚焦于封装基板等高端市场，目前国内参与者较少，竞争压力相对较小，另一方面公司也根据市场形势适时调整扩产进度。感谢您的关注！

14、看了一下公司应收账款较多，跟客户收款是采取怎么样的收款模式？按订单的进程还是什么？应收账款收不回来的风险大吗？

回复：尊敬的投资者，您好！2022 年末，公司应收账款净额 158,128.82 万元，占公司总资产的 13.30%，占营业收入的 29.54%，公司应收账款的账龄符合行业特点，但由于公司客户数量庞大，一定程度上增加了应收账款管理的成本与发生坏账的风险。公司制定了适当的信用策略及管控政策，根据客户的动态财务状况和履约情况，对新老客户的信用等级及时跟踪评估，对信用等级低的客户实行预收款制度，适时调整信用额度及收款期限，利用订单管理系统对逾期客户实施锁定订单等措施，并通过加强前端授信、事中监控、后端款项清收，做好应收账款风险管控工作；同时，进一步优化客户结构，打造能够抵御风险的优质客户群体。感谢您的关注！

15、公司目前产品应用场景有哪些？侧重点在哪些地方？

回复：尊敬的投资者，您好！公司产品广泛应用于通信设备、服务器、工业控制及仪器仪表、医疗电子、轨道交通、计算机应用、半导体等多个行业领域。感谢您的关注！

16、一般给客户送样认证周期需要多长时间？

	<p>回复：尊敬的投资者，您好！客户认证通常包括体系审核、样品试制、样品封装和可靠性认证、终端客户认证、小批量试产、量产。期间会涉及制程能力检核、多次品质体系认证、现场工作审核等。以 Intel 对于 FCBGA 封装基板供应商的标准认证流程为例，一个新基板供应商的认证周期约 3 至 4 年，目前最快的在 2.5 年左右。在国产化目标下，国内客户对我们的认证周期会较大幅度的缩短，一年以内应该能够完成认证进入量产。感谢您的关注！</p> <p>17、今年有哪些项目可以投产，产能分别有多少？</p> <p>回复：尊敬的投资者，您好。珠海 FCBGA 封装基板项目拟建设产能 200 万颗/月（约 6,000 平方米/月）的珠海 FCBGA 封装基板产线，已于 2022 年 12 月底建成并成功试产，预计 2023 年第二季度开始启动客户认证，第三季度进入小批量产品交付阶段。广州 FCBGA 封装基板项目已于 2022 年 9 月完成厂房封顶，预计 2023 年第四季度完成产线建设，开始试产。感谢您的关注！</p> <p>18、pcb 需求何时见底、回升？</p> <p>回复：尊敬的投资者，您好。从行业需求判断，2023 年 PCB 行业应该是前低后高趋势，2023 年 Q1 同比增速难有改善，预期 Q2 开始环比改善，三四季度行业同比增速有望转正，整体回暖幅度取决于宏观经济复苏的力度。感谢您的关注！</p>
附件清单	无
日期	2023 年 04 月 07 日